

**MEDIA TEK**

# 聯發科技 2024年第一季法人說明會 MediaTek 2024-Q1 Investor Conference

April 26, 2024



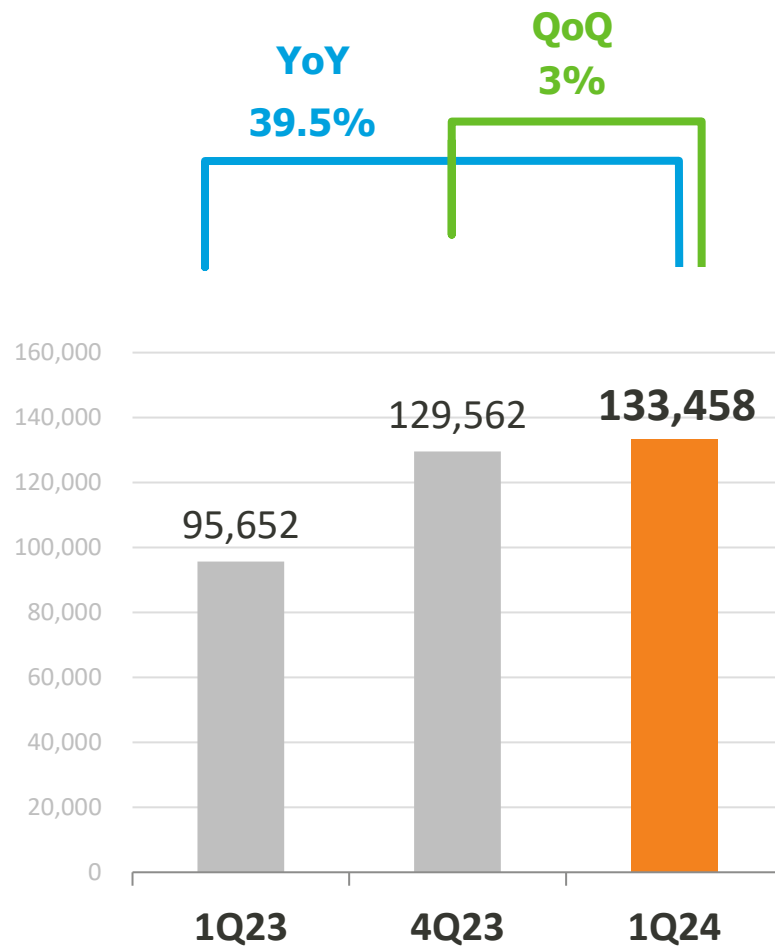
# 投資安全聲明

簡報內所提供之資訊(除歷史資訊外)屬預測性陳述，受到各種風險及不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發生顯著不符，這些不確定性因素包括：受到競爭性產品及定價之影響、設計是否及時被客戶接受、新技術是否及時導入利用、新產品大量量產之能力、產業及市場對半導體產品之供給及需求移轉、產業及市場是否供給過剩、製造產能可得利用情況、終端市場之財務穩定性、人才留任困難之可能性、無法預期之成本和費用、任何併購相關之不確定性，如主管機關核准之取得或整合延遲、重要客戶之流失、法律或行政訴訟之涉及、可能會影響營運之新法規、外匯匯率之波動、全球經濟因素或非經濟因素之影響及其他風險因素等。

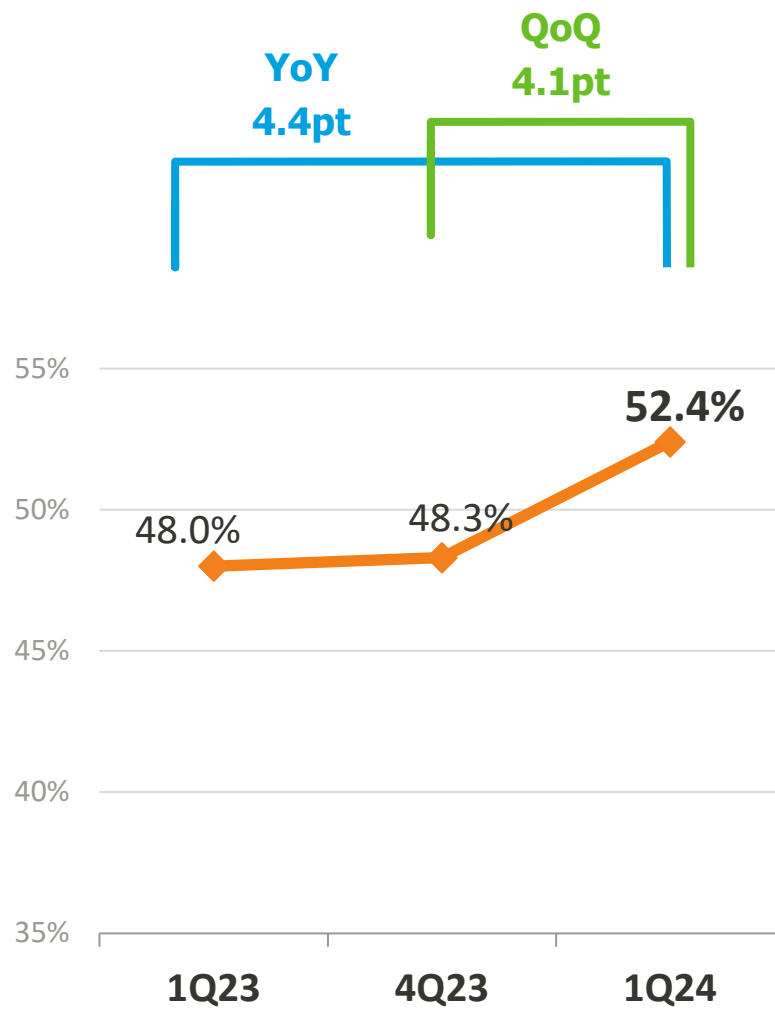
本簡報亦補充非以金管會認可之國際財務報導準則製作之財務資訊 **(Non-TIFRS)**，該資訊並未納入股份基礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等財務影響之考量。此補充資訊僅供參考而非替代以金管會認可之國際財務報導準則製作之資訊，請注意最終實際盈餘分配將依照國際財務報導準則製作之財務報告分配之。

# 合併營業收入

(單位：新台幣佰萬元)

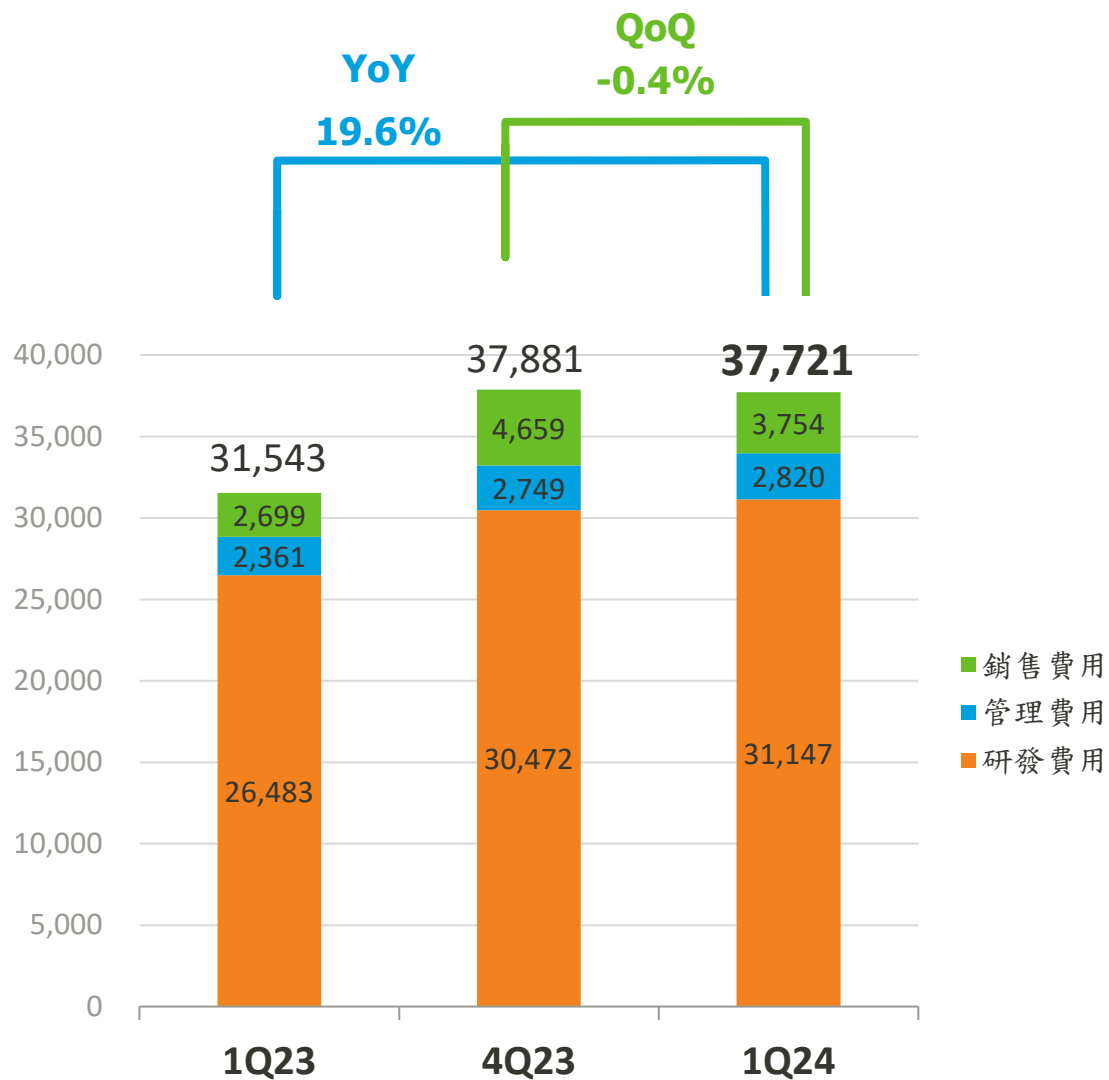


# 合併營業毛利率



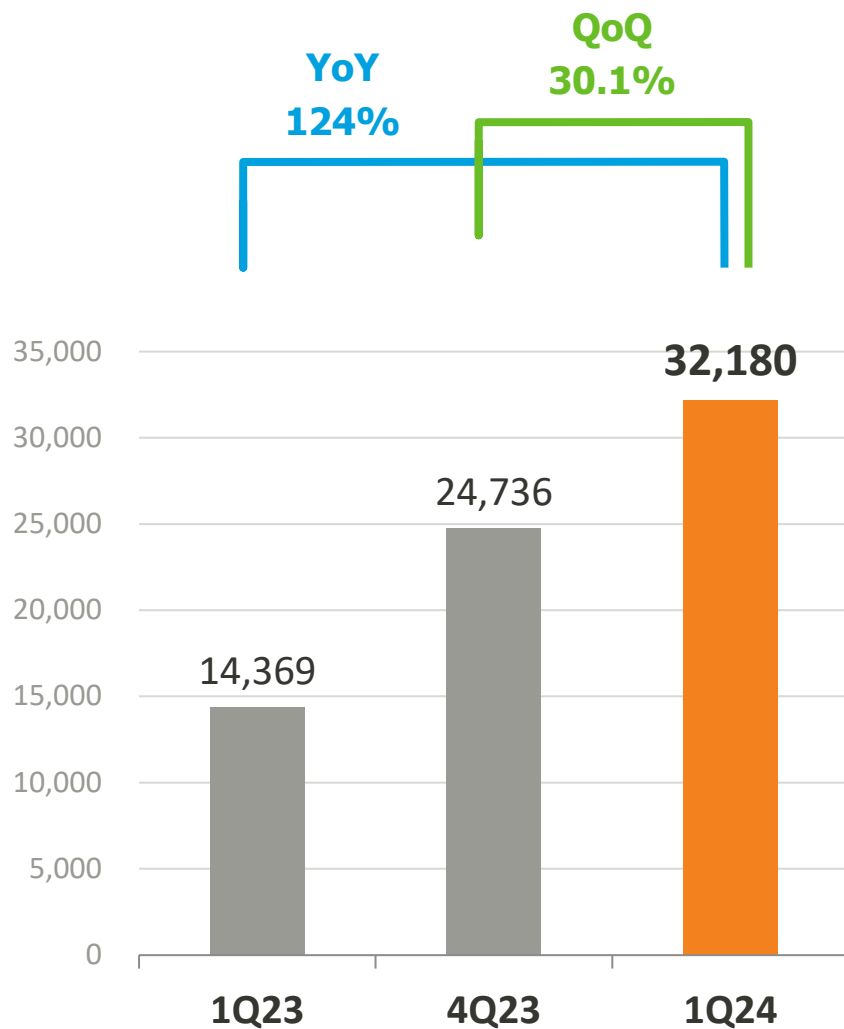
# 合併營業費用

(單位：新台幣佰萬元)

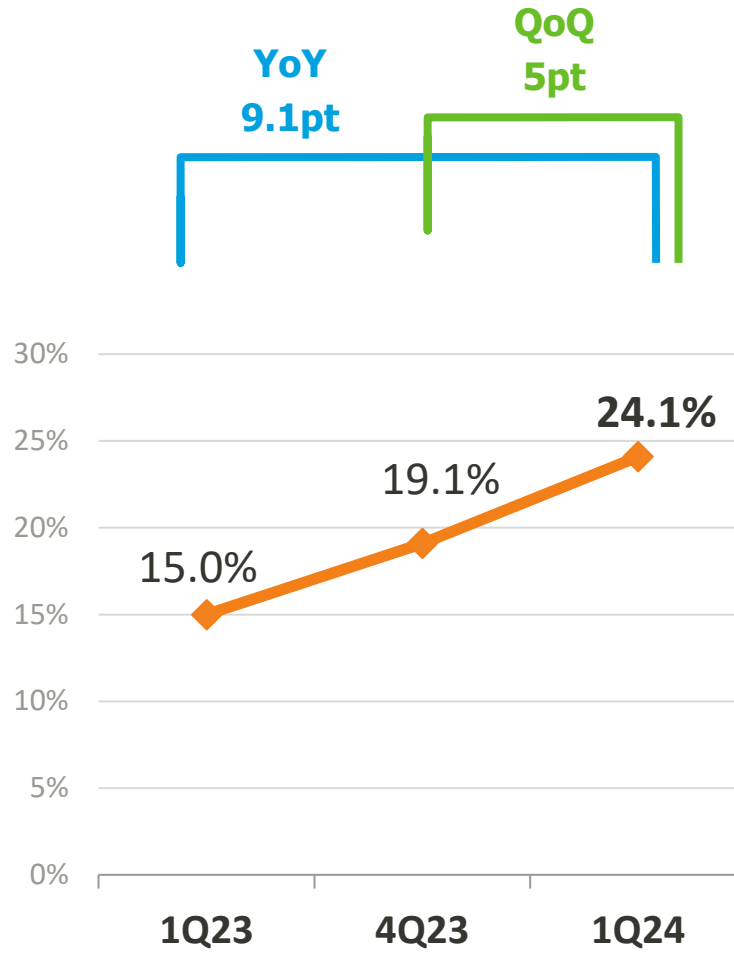


# 合併營業利益

(單位：新台幣佰萬元)

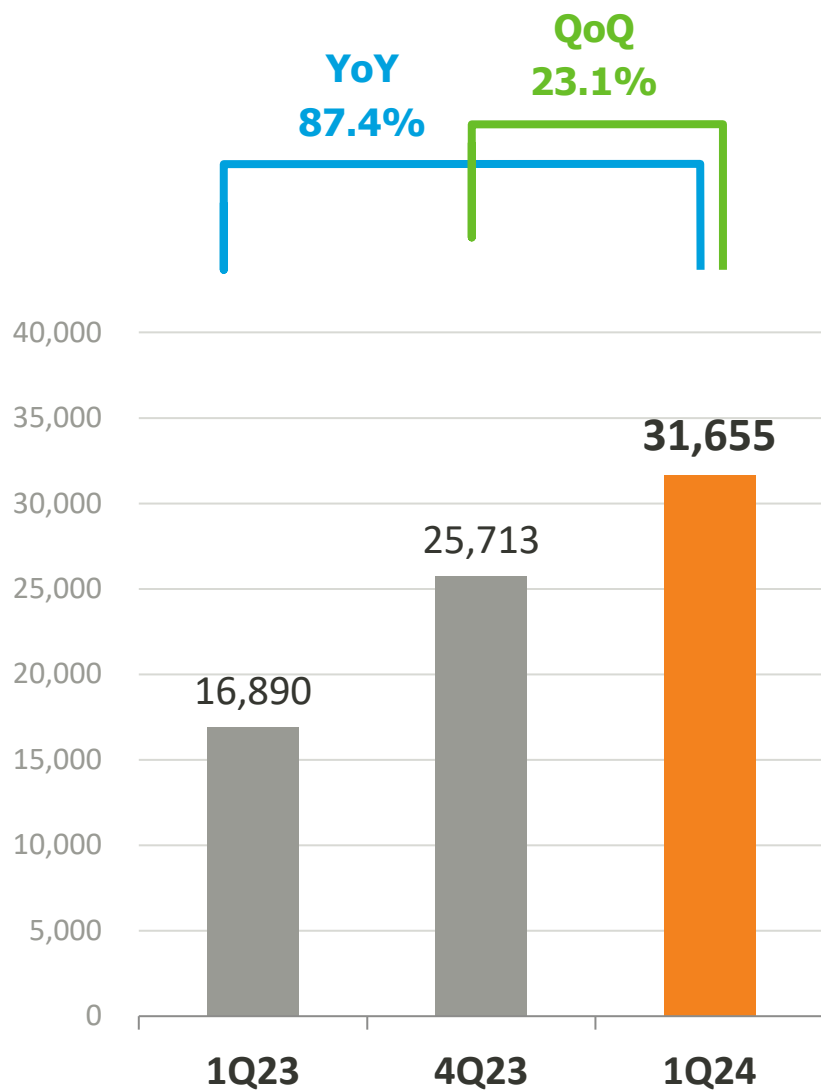


# 合併營業利益率



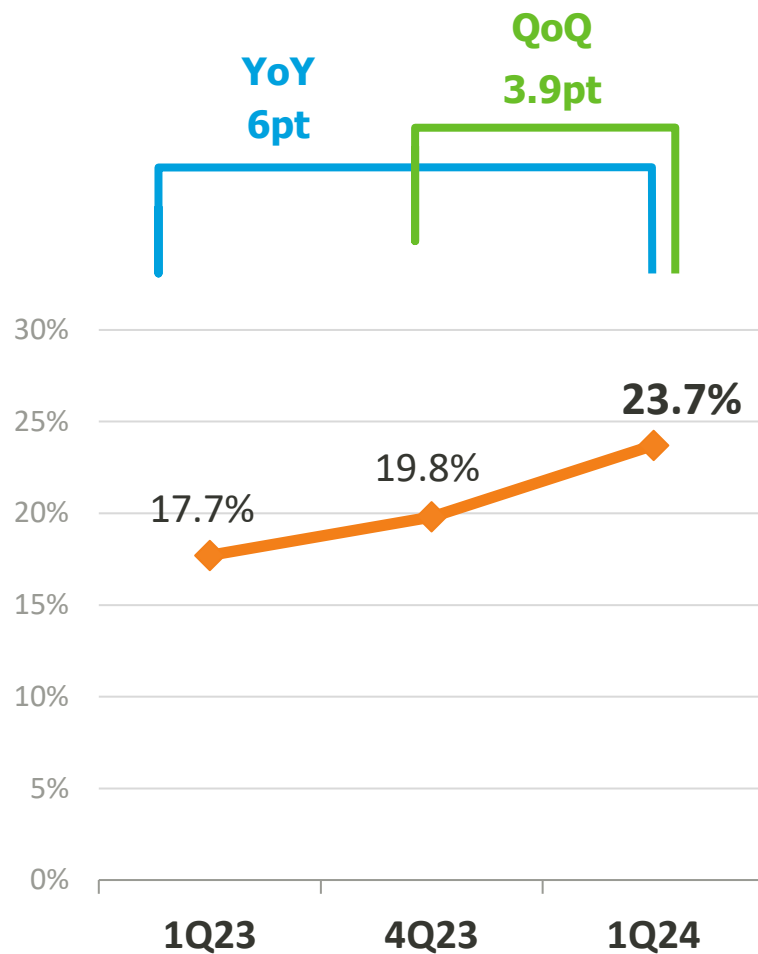
# 合併本期淨利

(單位：新台幣佰萬元)



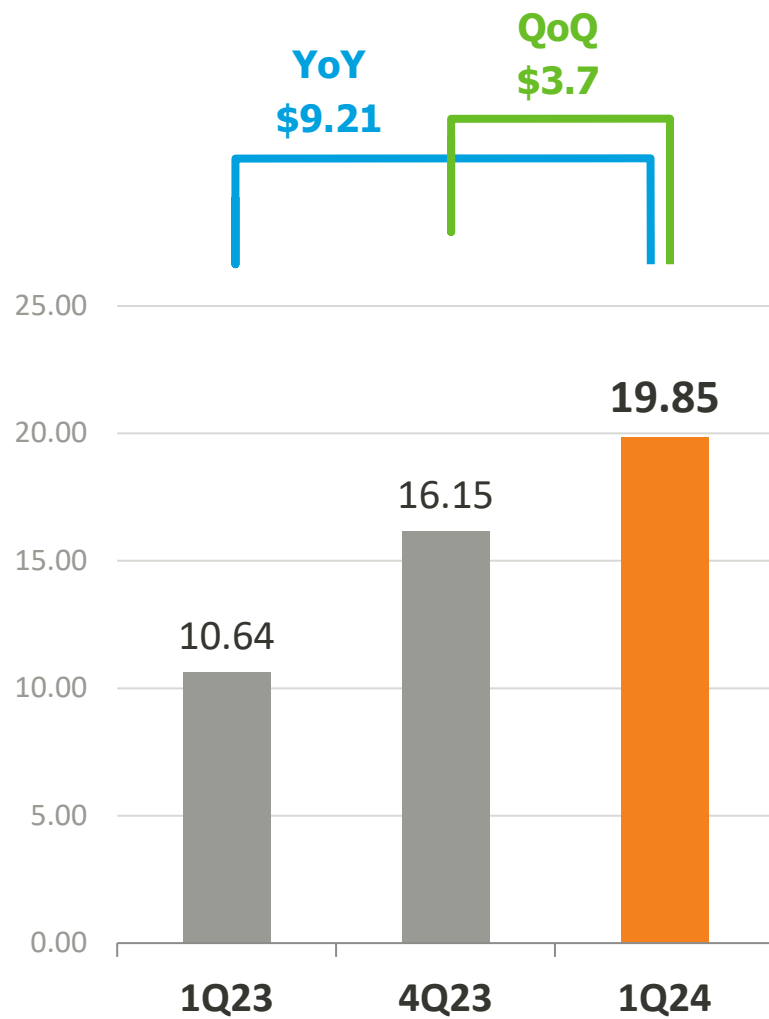


# 合併本期淨利率



# 合併每股盈餘

(單位：新台幣元)



# 2024年第二季營運展望

■ 合併營收: 約新台幣 1,214億 ~ 1,335億元

(假設2024-Q2美元兌新台幣平均匯率為1 : 32)

■ 合併毛利率: 47% ± 1.5%

■ 合併營業費用率: 30% ± 2%

# 金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)

## 財務報表

# 聯發科技股份有限公司

## 合併損益表(自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2024年 第一季	2023年 第四季	2023年 第一季	Q-Q	Y-Y
營業收入	133,458	129,562	95,652	3.0%	39.5%
營業成本	(63,558)	(66,946)	(49,739)		
營業毛利	69,901	62,616	45,912	11.6%	52.2%
推銷費用	(3,754)	(4,659)	(2,699)		
管理費用	(2,820)	(2,749)	(2,361)		
研究發展費用	(31,147)	(30,472)	(26,483)		
營業費用合計	(37,721)	(37,881)	(31,543)		
營業利益	32,180	24,736	14,369	30.1%	124.0%
營業外收入及支出	3,490	3,580	4,735		
稅前淨利	35,670	28,316	19,104		
所得稅費用	(4,015)	(2,602)	(2,213)		
本期淨利	31,655	25,713	16,890	23.1%	87.4%
母公司業主	31,536	25,663	16,874	22.9%	86.9%
非控制權益	119	50	17		
<b>每股盈餘(元)</b>	<b>19.85</b>	<b>16.15</b>	<b>10.64</b>		
平均匯率(美金/新台幣)	31.44	31.83	30.40		

註: 數字加總不等, 因四捨五入造成。

# 聯發科技股份有限公司

## 合併損益表(佔營收比例)

	2024年 第一季	2023年 第四季	2023年 第一季
營業毛利率	<b>52.4%</b>	<b>48.3%</b>	<b>48.0%</b>
推銷費用率	(2.8%)	(3.6%)	(2.8%)
管理費用率	(2.1%)	(2.1%)	(2.5%)
研究發展費用率	(23.3%)	(23.5%)	(27.7%)
營業利益率	<b>24.1%</b>	<b>19.1%</b>	<b>15.0%</b>
營業外收入及支出率	2.6%	2.8%	5.0%
所得稅費用率	(3.0%)	(2.0%)	(2.3%)
本期淨利率	<b>23.7%</b>	<b>19.8%</b>	<b>17.7%</b>

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

# 聯發科技股份有限公司

## 合併資產負債表(自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2024年 第一季	2023年 第四季	2023年 第一季
現金及金融資產-流動	159,767	180,673	154,710
應收帳款淨額	54,104	55,106	46,311
存貨淨額	49,212	43,220	69,265
其他流動資產	21,618	11,889	21,173
基金及投資	175,701	150,006	131,226
無形資產	80,033	81,245	78,375
其他非流動資產	106,890	112,899	111,326
資產總計	647,325	635,038	612,385
短期借款	7,820	2,200	4,600
應付帳款	39,997	38,779	21,169
其他流動負債	199,848	191,020	221,138
非流動負債合計	24,788	28,834	26,506
權益總計	374,874	374,205	338,972

註: 數字加總不等, 因四捨五入造成。

# 聯發科技股份有限公司 合併現金流量表(自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2024年 第一季	2023年 第四季	2023年 第一季
營業活動之淨現金流入(出)	25,204	101,536	2,858
投資活動之淨現金流入(出)	(18,271)	(7,473)	(9,955)
籌資活動之淨現金流入(出)	(33,881)	(24,884)	667
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,897	(7,738)	(1,375)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(22,051)	61,441	(7,806)
期末現金及約當現金餘額	143,345	165,396	139,696

註: 數字加總不等, 因四捨五入造成。



## 補充資訊

非金管會認可之國際財務報導準則**(Non-TIFRS)**

財務資訊調節表及季度營收產品類別

# 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)

## 財務資訊調節表<sup>註2</sup>

(單位:新台幣佰萬元)

		2024年 第一季	2023年 第四季	2023年 第一季	Q-Q	Y-Y
TIFRS	營業利益	32,180	24,736	14,369	30.1%	124.0%
	營業利益率(%)	24.1%	19.1%	15.0%		
調節項目	股份基礎給付獎勵	173	269	566		
	因企業合併產生之資產增值攤銷	75	75	126		
Non-TIFRS	<b>營業利益</b>	<b>32,428</b>	<b>25,079</b>	<b>15,061</b>	29.3%	115.3%
	<b>營業利益率(%)</b>	<b>24.3%</b>	<b>19.4%</b>	<b>15.7%</b>		

TIFRS	本期淨利	31,655	25,713	16,890	23.1%	87.4%
	本期淨利率(%)	23.7%	19.8%	17.7%		
	本期淨利-母公司業主 每股盈餘(NT\$)	31,536 19.85	25,663 16.15	16,874 10.64	22.9%	86.9%
調節項目	股份基礎給付獎勵	173	269	566		
	因企業合併產生之資產增值攤銷	75	75	126		
	所得稅影響數	(34)	(46)	(94)		
Non-TIFRS	<b>本期淨利</b>	<b>31,869</b>	<b>26,010</b>	<b>17,488</b>	22.5%	82.2%
	<b>本期淨利率(%)</b>	<b>23.9%</b>	<b>20.1%</b>	<b>18.3%</b>		
	本期淨利-母公司業主	31,745	25,954	17,449	22.3%	81.9%
	<b>每股盈餘(NT\$)</b>	<b>19.98</b>	<b>16.34</b>	<b>11.00</b>		

註1:數字加總不等,因四捨五入造成。

註2:非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊,調節項目為股份基礎給付獎勵、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等,其僅為補充而非替代資訊,且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準。

## 本季產品類別營收佔比

產品類別*	1Q24 營收佔比(註1)	QoQ%	YoY%
Mobile Phone	61%	-2%	84%
Smart Edge Platforms	34%	16%	2%
Power IC	5%	-13%	1%
Total	100%	3%	40%

註1:百分比加總不等於100%，因四捨五入造成。

\* **Mobile Phone:** 5G/4G/3G智慧型手機、功能型手機

**Smart Edge Platforms:** 各類連網應用如路由器、寬頻網路、PON、筆記型電腦、無線藍牙耳機、智慧音箱及汽車等的無線/有線通訊晶片與單晶片；ARM架構運算單晶片及物聯網；電視；消費性/企業級客製化晶片服務

**Power IC:** 電源管理晶片

[www.mediatek.com](http://www.mediatek.com)